



שבב המודם הסלולארי נכון להיום הוא שבב נפרד. כל היצרניות שמתבססות במכשיריהם מעבדי ה-Snapdragon 855 של קוואלקום יצטרכו להשתמש במודם 5G כרכיב נפרד. נכון להיום כל היצרניות הגדולות, כולל קוואלקום, מדיה-טק, אפל וסמסונג מציעות שבב חיצוני.

ואולם סוכנות הידיעות הקוריאנית יונהאפ, מוסרת כי סמסונג תהיה הראשונה להשיק מערכת על שבב שתכיל מודם 5G כחלק אינטגרלי לפני סוף 2019, כך שהוא ישולב כבר בתחילת 2020 במכשירים החדשים. המתחרות העיקריות לא אמורות להציג מערך דומה לפני אמצע הרבעון הראשון של 2020, כך שסמסונג תהיה הראשונה לעשות זאת.

שילוב המודם בתוך המערכת על שבב יקטין את סך טביעת הרגל של חלקי המערכת, מכיוון שלא יהיה צורך למצוא מקום לשבב נוסף, וכן את צריכת הכוח הכוללת – כך שבסופו של דבר תהיה לכך השפעה על ביצועי הטלפון מבחינת זמן עבודה.

כזכור, אפל רכשה לאחרונה את עסקי המודמים לדור החמישי של אינטל, כדי להגיע אף היא לעצמאות בתחום זה ולשלב את המודם בתוך המעבדים של האיפון.

{loadposition content-related}

)